



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 21. marraskuuta 2018
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

SAATE

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	19. marraskuuta 2018
Vastaanottaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin
Kom:n asiak. nro:	C(2018) 7499 final - Liite
Asia:	LIITE asiakirjaan Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen toimivan sähköliitoksen puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa mahdollistavissa juotoksissa käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2018) 7499 final - Liite.

Liite: C(2018) 7499 final - Liite



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

Komission delegoitu direktiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen toimivan sähköliitoksen puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip –tekniikassa mahdollistavissa juotoksissa käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta

LIITE

Korvataan liitteessä III oleva poikkeus 15 seuraavasti:

”15	Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa	Koskee luokkia 8, 9 ja 11 ja päättyy – 21.7.2021 luokkien 8 ja 9 osalta, lukuun ottamatta in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita, – 21.7.2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta, – 21.7.2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta.
15 a	Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa, kun vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy – puolijohdeteknologian solmupiste, joka on vähintään 90 nm, – yksi puolijohdepala, jonka koko on vähintään, 300 mm² missä tahansa puolijohdeteknologian solmupisteessä, – pinotut puolijohdepalaryhmät, joissa yksi puolijohdepala on vähintään 300 mm² tai piivälittäjä vähintään 300 mm².	Koskee luokkia 1–7 ja 10 ja päättyy 21.7.2021.”